

中期経営計画説明会 要旨

説明会概要

2022年3月3日（木） 10:00 - 11:00

Zoom ウェビナー

機関投資家・アナリスト向け

（スライド1）

2030年のビジョン、フェーズ1 中期経営計画（2022～24年）について説明します。

（スライド2）

まず初めに、中期経営計画（以下、「中計」）策定にあたっての概念、本中計の位置づけです。2番目に、2030年に目指すべき企業像、ビジョンです。そして3番目が、中計（2022年～24年）のビジョン、フェーズ1について、そして4番目に、重要な資本政策を説明します。

（スライド4：理念体系図）

私は、社是「仕事を楽しむ」が一番重要だと考えています。当社は「独創的な技術」を研究開発で生みだし、社会に貢献し続けてきました。研究開発で技術を生み出すことが競争力の源泉です。そして利益を稼ぎ、再分配・再投資を繰り返していくという、非常に長い期間に渡って、ステークホルダーの信頼を勝ち得ながら、事業を継続していくという営みを続けてきました。その基本が「仕事を楽しむ」という考え方です。この社是は、1969年の創業からほどなくして制定されました。仕事を楽しみながら、社員が十分に力を発揮するということが、お客様に満足していただくことに直結します。その結果、利益の還元と再投資の継続が非常に重要だと考えています。そして、経営理念、2030年のビジョンがあり、中計があります。

（スライド5：本中期経営計画の位置づけ）

2030年に向けた最初のフェーズ1で、今回は2022～24年についての中計となります。

（スライド7：目指す企業像）

当社は以前からグローバル展開をしています。グローバリズムが、自由・闊達さを謳歌していた時代から考えると、現在はこれまでのようにグローバリズムの追及は簡単ではなくなりました。しかし、半導体や電子部品は世界中で必要であり、サプライチェーンも世界中に広がっています。難しく複雑になった状況でも、当社は、戦略的な、本当の意味でのグローバルカンパニーになっていくという挑戦のステージと考え、これを第一に掲げています。

2 番目に、これも大変重要です。「研究開発型の企業であり続ける」。冒頭で申し上げたとおり、技術を生み続けること。ずっと続けることが非常に大事です。そして技術を持って差別化を図るといこと。他社とは異なる価値を生むという意味で、当社の DNA 的なものでもあります。研究開発型企業であり続けるということは必要不可欠です。これがなくなれば、当社の存在価値はないと考えています。

競争力を高めて再投資する、社員に活躍の場を広げて、お客様を通じて社会に貢献する。そのために、研究開発型企業であり続ける。そして今あるコア技術から、あるいはそれ以外の所からもシーズを研究開発で育てたいと考えています。

3 つ目は、当社は、界面（物質と物質の境界面）に化学処理や物理処理をすることで価値を生みだしてきた会社です。電子基板を中心に、銅と樹脂との界面が一番大きなビジネス領域ですが、そこを非常に深掘りしてきた会社として、大変ユニークなデータを蓄積しています。例えば、独特な粗化形状等の画像識別、こういったことからある種の学習を経てさまざまな予測が可能になってきます。こういった作業を通じて自社内における開発の飛躍的な成果や、生産管理の質向上といった社内効率化の成果にとどまらず、独創的な予測の技術は、それ自体がビジネスチャンスにもなり得ると考えています。当社として、AI 企業としての顔を持つことをビジョンとして挙げました。

（スライド 8：成長し続ける会社であるための当社のビジネスモデル）

当社は、研究開発型企業として価値ある製品を顧客に提供し、社会に貢献し続ける。例えば、5G や高速インターネット、クラウド、自動運転のサポート等、これらを通じて社会に貢献していきます。

（スライド 9：2030 年への指針）

「つくる」を変える。

例えば、時代に合わないことをやっているのではないか？ そうであればどんどん変えていこうということです。生産に関しては、もう一度基本に立ち返り、生産性の向上を目指しています。開発については、これまで電子基板向け中心でしたが、そこに限定することなく、開発と生産以外でもコア技術が役立つ方向で開発しようと進めています。今のやり方や常識に照らして見つめなおし、変えるべきは変えていこうと考えています。

「うる」を変える。

「つくる」があれば「うる」がある。薬品を販売するだけでなく、本質的にはお客様には生産性や良品率向上、余分な投資の抑制、環境負荷低減等をしていただく。本来もっと環境負荷が大きかった所に、当社のプロセスを使っただくことで効率化がはかられ、結果、環境負荷が下がることを目指しています。また、技術に関わる情報を提供し、その価値に見合った対価が得られるように活動していく必要があると考えています。

(スライド 10：目指す人財像と組織)

目指す人財像と組織について触れています。

「各自自立自走し連帯できる人財を目指す」「熱意を持ち挑戦を続ける人である」「基本的なデジタルリテラシーを持つ」。当社の仕事はある程度連携してやらないといけません。自立自走した上で連帯できる人財。そして大事なことは、最終的に人を動かすのは熱意であり、そして挑戦を避けることはあり得ない。挑戦をしないとイケない。そうでなければ価値は生めないと考えています。

そしてこれからは、全員が基本的なデジタルリテラシーを持っていくことが大事と考えています。

これらが冒頭にあげた「仕事を楽しむ」に繋がります。さらに、仕事はアマチュアではなくプロとしてやって欲しい。プロ同士だからこそ、お互いにリスペクトもできるし、リスペクトがあるから、よい仕事ができ、連帯もできると考えます。

(スライド 11：本中期経営計画のロジック)

本中計がどういう位置にあるかを示しています。大事なことは、当社社員全員が自分のこととして取り組むことだと思っています。

(スライド 13：社会動向の変容)

最近の社会の変化や変革の中、当社がこれからどのように進むか。

「DX の進展」については、コロナ禍でデジタルトランスフォーメーション (DX) の進展はかなり後押しされています。当社事業は特に半導体に関係しており、DX の進展は当社にとって追い風となります。

「米中 2 軸の世界観」は、今までのようにグローバリズムの追及は簡単ではなくなりました。今後は米中 2 軸、この世界観の中でやっていかなければなりません。今はさらに状況が複雑化、混沌化し、このような中どのように世界に価値をもたらしていくのかを考えていきます。

「脱炭素への動き」は、長期的には脱炭素への動きは、いろいろな物事を効率化していく、新しい技術を生み出すという過程や結果において、さらに多くの半導体が必要になることを意味しています。

「SDGs への挑戦」は、顧客の歩留まりや良品率向上、そして生産性やスループット向上、環境負荷の低減等に貢献することが、SDGs に関わることだと考えています。それらを具現化させ当社の目標とすることが課題としてあります。また、SDGs をきっかけに、新たなシーズやビジネスチャンスを得る機会であるとも捉えています。

(スライド 14：2024 年数値目標 (連結))

売上は示していません。当社は半導体に関わる事業が約半分あり、特に半導体のロジック

やメモリー等、かなり高精細で高密度な最先端の部分に関わっています。半導体メーカー各社が旺盛な投資意欲をみせていて、半導体後工程に使用されるパッケージ基板メーカーも同様に、かなり意欲的な投資計画を挙げています。さらには、半導体製造装置メーカー等も非常に意欲的な数字を挙げています。今後、かなりビジネスが拡大することは間違いなく、そういう環境で、売上を伸ばしていきます。

当社の売上の少なくとも半分が半導体のロジックやメモリー等に関係し、残りの部分は電子部品や電子基板、ディスプレイが多く、中期的には全体的に増えていく傾向があります。当社として、それなりの売上が伸びているのは、常に市場から期待されていると考え、今後事業の計画、活動に取り組んでいきます。

数値目標の指標として、「営業利益率 20%以上」「ROE10%以上」を挙げました。これは、当社が最低限維持すべき数値と考えています。2021 年度は、すでにこれら数値目標を上回っています。基本的には、よりよい数値を目指していくということです。決して特別なリスクがあるわけではありません。

資本効率を上げるため、利益率、ROE を上げていくことに取り組んでいきます。一時的な不景気や不況があっても、当社としては目標とする数値を割り込まないよう事業体質の強化やポートフォリオを確認しながら、「営業利益率 20%以上」「ROE10%以上」を最低限と認識した上で、目標としてクリアできるように頑張っていきたいという趣旨です。

(スライド 16：半導体市場の見通し)

「DX の進展」「脱炭素の社会的動向」を背景に、データ量の増加、通信の高速化が促進されます。また、センシング、モニタリング、シミュレーティング等が不可欠になってきます。これまでの半導体業界は、世界景気に影響を受けましたが、現在は、景気にかかわらず、短・中期的に多少の浮き沈みはあっても、半導体市場は大きく拡大すると考えています。当社は 2000 年以降 21 世紀に入ってから、世界の半導体の伸びと同じような形で業績を伸ばしてきました。おそらく当面は、その傾向は変わらないと考えています。

(スライド 18：事業分野における経営課題)

まず、技術・マーケティングについて。

「物理密着から化学密着への技術変化への対応」では、「化学密着技術の確立」を挙げています。「物理密着」は、銅表面を粗化し、その面の上に樹脂を貼り付けて取れないようにする技術です。「化学密着」は、銅表面を機械的あるいは物理的に粗化せずに、真っ平らなまま樹脂との密着をはかるという技術です。この「化学密着技術」が非常に重要で、ここは技術的にも最先端で、当社の研究開発で今まで最も注力し、今後も注力していく分野です。しかしながら、パッケージ基板の領域において、粗化せず化学密着単独という技術は、かなり先になるのではないかと予想しています。

「既存技術の応用展開」については、例えば、より半導体に近い分野やディスプレイの分

野等を開拓していきたいと考えています。

「新規市場への進出」「新規事業への創出」については、例えば、熱伝導に関すること、あるいはリサイクルに関すること等。そして、識別から予測する AI に関することです。それらを中心にシーズを作り、今後のチャンスに活かしていく所存です。

次に、生産・ロジスティックスについて。

グローバル生産戦略の構築と、連結視点での安定した調達、生産、供給体制の確立ですが、
<原材料を仕入れ、生産し、お客様に納める>この当たり前の製造業の営みは、以前からの比較において、これが複雑になってきていると思います。そして、品質管理への要求も、年々高まっていると感じています。そのため、今一度、体制構築に努めたいと考えています。

(スライド 19：半導体市場の見通し)

スマートフォンや PC、データセンター、5G インフラに使われるロジックとメモリーのボリュームが多いです。当社にとっては、下右側表の赤い点線で囲んだ部分（ロジックとメモリー、一部アナログ LSI 等）が主要なビジネス領域です。いずれも高精細・高密度なパッケージ基板を使います。当社は高密度・高精細な領域が得意であり主戦場です。

(スライド 20：物理密着の変遷)

CZ シリーズは、銅表面を粗化し樹脂との密着力を向上させる製品です。現在の主流は「CZ-8101」であり、当面続くと思っています。パッケージ基板の高密度・高精細化が進むと、さらに細かい粗化形状をつくる「CZ-8201」が使用されます。開発中の「CZ-8401+化学密着」はさらにその先のタイプであり、次期中計以降で、かなり大きく伸びていくと考えています。

(スライド 21：粗化と無粗化技術)

大事なところ。無粗化技術（＝化学密着）。

最も重要な開発技術として、これまでも、これからも非常に力を入れています。この技術に対する自信は凄くあります。「無粗化技術」は、機械的・物理的な助けがなく、樹脂が食いつく金属の粗化形状がありません。銅の平面な面と樹脂との密着強度を上げる必要があります。そのため、銅の表面に薄い皮膜を付けます。それには樹脂と被膜との相性が非常に重要となります。また、前後工程との兼ね合いも非常に重要になってきます。そういった難しさがあるため、無粗化（化学密着）を単独で用いるのではなく、例えば、化学密着の前に微粗化する等の前処理を入れるといったハイブリッドなものが、最先端の領域で先行すると考えられます。完全無粗化処理（＝化学処理）は、パッケージ基板の量産においては、だいたい先になるのではないかと思います。一部非常に限られた所では使われるであろうと考えます。

最先端の無粗化単独の化学処理が最先端パッケージ基板に使用される頃には、おそらく、

粗化処理も今よりかなり大きく増えているだろうというのが当社の考えです。非常に限られた本当に必要な所は、無粗化あるいは化学処理単独で必要になると思います。それは、超高密度あるいは超高周波のため必要な技術ですが、汎用的な部分に関しては、粗化技術が増加すると考えています。

(スライド 22：コア技術をベースとした新規市場への進出)

プロダクトアウトの部分で新しいことをするために、組織を見直す等しています。

(スライド 23：グローバル生産&ロジスティクスの将来像)

SDGs 観点での取り組みは、例えば、物流の見直し等で無駄を省くことを考えていきます。

(スライド 25：経営戦略と人事戦略の連動)

ここで一番申し上げたいのは、今後の経営戦略に見合う形の人財開発をしっかりとやっていきたいということです。これは、採用・育成共です。

今期は、処遇改善のため思い切った形で社員の報酬体系も見直します。当社は社員を大事にする会社であると自負しています。価値の源泉は、やはり、社員の活躍です。

(スライド 26：人事戦略の方向性)

人財は、資源として使って終わりということではなく「資本」です。最も大切な会社の財産です。顧客に価値をもたらし、リターンをもたらす。この人的資本という考えをもって、物事にあたっていきます。

(スライド 28：メックの価値創造モデル)

当社にとって特徴的なことは、「仕事を楽しむ」「研究開発」そして「金属表面処理技術」です。ガバナンス・経営基盤をしっかりさせた上で、研究開発で製品競争力あるいはサービスの競争力をつけて、そしてお客様に提供し、これを廻すことで継続性をもたせ、再投資し成長していきます。

アウトプットでは、真ん中の黄色部分、PCB、最先端パッケージ製造において、常に、歩留まり向上、無駄の削減、生産性の最大化を狙っています。

その結果、アウトカムとして、社会への貢献、例えば、5G の実現や AI の活用、自動運転、DX の進展といった所に幅広く役に立つということ。もちろん、SDGs への挑戦、脱炭素社会への貢献といったことにもチャレンジしていくという所存です。

(スライド 29：CSR マテリアリティ (重要課題))

ここも非常に重要なところです。

当社は、「未来を切り開く研究開発」が重要で、特色があり、これが基本の軸になってい

ます。

高付加価値製品を開発し提供するとその結果、お客様の生産性向上に貢献する、歩留まり向上に寄与することで環境負荷低減に繋がります。

化学メーカーである当社は、環境保全は非常に重要であると認識しています。

そして、グローバルに展開していますので、適正な調達、生産、物流も非常に重要なことであり非常に特色があります。

品質と安全、多様な人財の活用、経営基盤の強化は、非常に重要であり、かつ、他社と比較的差がない部分と思います。ただ、多様な人財の活用では、人がいかに楽しく、満足して働くかということ、より一層重要に考えています。

(スライド 30：当社がかかわる SDGs)

SDGs は、今後きちんと目標を整理・設定し達成するよう進めます。

(スライド 31：今後取り組むべきこと)

環境負荷に低減に寄与する、社会・産業・顧客の発展に寄与する。

新たにに取り組む課題・世の中の要求についても、環境負荷低減、環境保全にさらに取り組むということです。

(スライド 32：資本政策)

研究開発に関する投資では、毎年連結売上高の約 10%を投資してまいります。当社の価値の源泉であり、先行投資は今後も継続していきます。

設備投資は、向こう 3 年累計で約 50 億円。先般プレスリリースした新しい生産工場の約 30 億円も含めた数字です。

株主還元としては、連結配当性向 30%を念頭におき、安定的に配当していく考えです。自己株取得については、状況に応じ機動的に実施するということです。

営業利益率 20%以上、ROE10%以上をしっかりと維持しながら、さらにチャンスがあれば投資をするというように考えています。